

# MEMS



CSMicrosensor(Ningbo)Technology Co.,Ltd.

## 启微数感

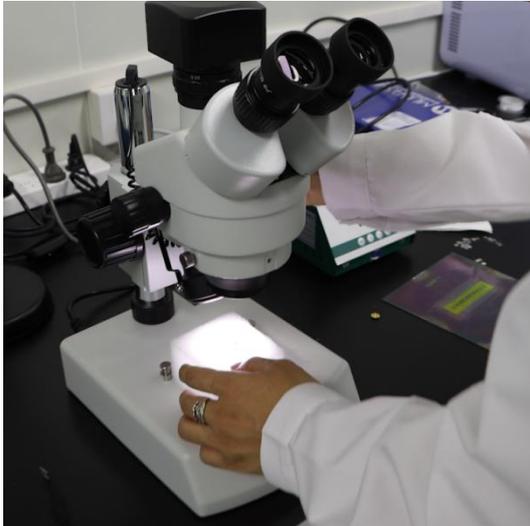
### 材料沉积服务

Material Deposition Service

## 一、解决方案

提供材料沉积服务，帮助沉积（点胶）制作 MEMS 气体传感器，适用于 T05 和 DFN 封装。

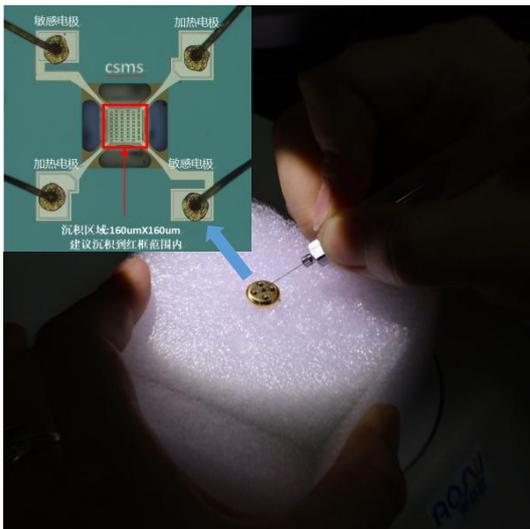
## 二、绑线流程（以 T05 做示范）



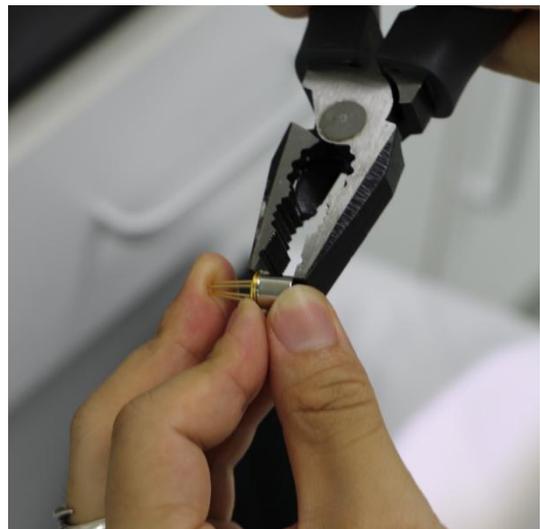
Step1 将绑好线的 TO5 传感器放到显微镜下



Step2 手持点胶机（针筒等点胶设备）点涂



Step3 点涂到中心区域，完成点胶



Step4 使用钳子等夹具轻微夹紧，即可完成

## 三、服务内容：

**材料提供：**可提供粉末/胶体材料（若提供粉末材料，我们将为您制作成胶体），用于 MEMS 气体传感器的沉积。

**沉积工艺：**根据客户要求选择（一般推荐手动点胶，也提供点胶机、喷墨打印机等沉积设备服务），具体可咨询官方客服。

**封装适配：**根据客户要求，进行 T05 或 DFN 封装的适配工作。

**封装验证：**保证绑线是否连接完整，在点胶后观察完毕后进行加热电阻的测试，通过测试后给到客户。